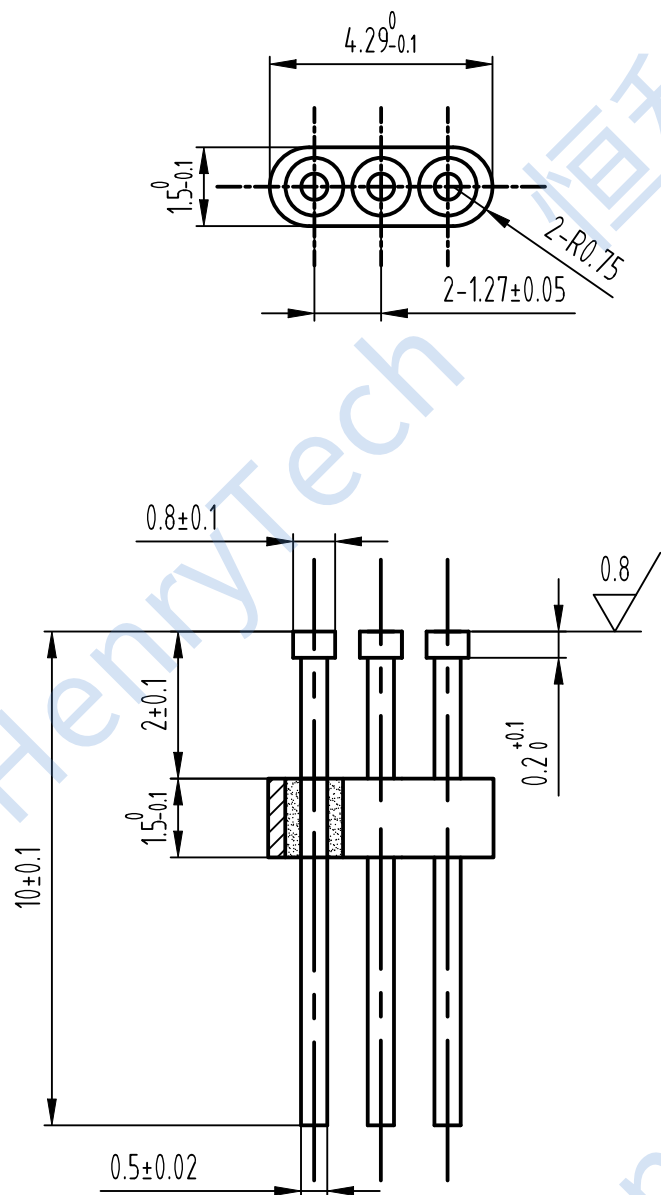




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP3-0.5-1.27(10-2)
-T0.8

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

设计	M.	标准化	日期
审核			
工艺		日期	

图样标记

重量

比例

7:1

共 页

第 页